



日立ハイテク
HITACHI

例えるなら、
300ヤードのティーショットを、
確実にピンから1ヤード以内に
打てる正確性。

半導体デバイスの検査工程^{*}において、
高精度測長再現性0.3nmを実現する技術。
*試料:日立標準ウェーハ

高精度測長再現性0.3nm・像分解能1.8nm
日立高分解能FEB測長装置 CG4000

半導体デバイスの飛躍的な進化と共に求められているのが、より高精度な半導体デバイスの検査工程。日立高分解能FEB測長装置「CG4000」は、極小パターン計測におけるばらつきを大幅に低減し、高精度測長再現性0.3nmを実現しました。さらに、日立測長SEM史上最高の分解能1.8nm、高スループット30枚/hを実現。日立DesignGaugeとの接続により、設計データとウェーハ上のパターン形状の形状誤差を計測可能にして、OPC検証のための新たな計測データを提供。新プロセス/材料に対応した新測定技術や新アプリケーション技術を搭載し、精度や効率を飛躍的に向上させた「CG4000」は、次世代の半導体デバイスに総合的に対応して生産性向上を強力にサポートします。

再現性 検索



日立高分解能FEB測長装置 CG4000
設計データとSEM画像との重ね合わせ図
設計データ応用計測システム DesignGauge
*DesignGaugeは(株)日立ハイテク/ロジックの日本登録商標です。

家電、パソコン、自動車、建築、携帯電話など、私たちの生活に関わる多くのものに欠かせない半導体デバイス。この半導体デバイスの品質管理に不可欠なのが、回路を数十万倍に拡大してナノメートル単位で検査する「測長SEM」です。日立ハイテクは着実に微細化が進む半導体デバイスの製造プロセスにおけるニーズを先取りし、最先端の精度を実現した新型FEB測長SEMを投入します。

最先端を、最前線へ。日立ハイテク
日立ハイテク開発力 × 日立ハイテク技術力 × 日立ハイテク商社力 → 日立ハイテクソリューション

日立ハイテクは「SEMICON Japan 2007」に出展します
12・5(Wed) ▶ 12・7(Fri) 幕張メッセ国際展示ホール HALL1 1-D-1001、HALL9 9C-705

株式会社日立ハイテクノロジーズ
〒105-8717 東京都港区西新橋1丁目24番14号 電話(03)3504-7111 <http://www.hitachi-hitec.com>